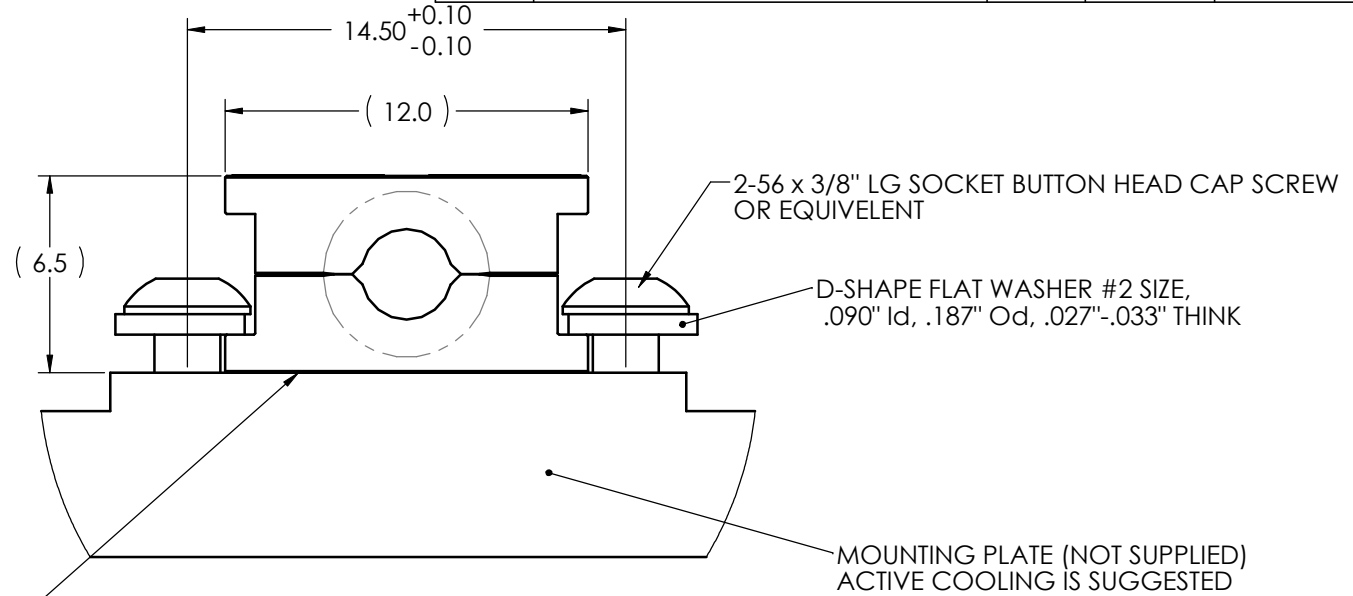


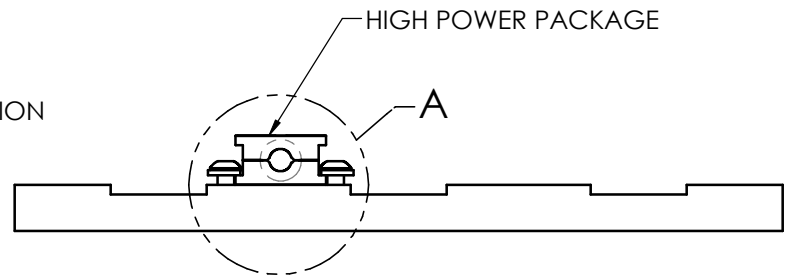
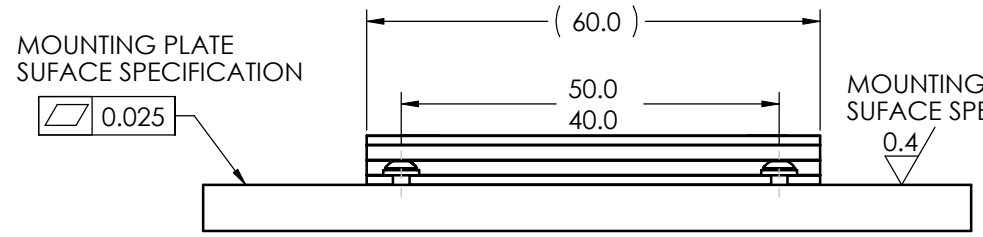
RÉVISIONS				
REV	DESCRIPTION	DATE	RÉVISÉ	APPROUVÉ
01	REMOVE MENTION OF THERMAL PASTE	2/25/2011	AW	AW



USE SUPPLIED GRAPHITE PAPER  $\triangle 01$   
BETWEEN COMPONENT AND MOUNTING PLATE

MOUNTING PLATE (NOT SUPPLIED)  
ACTIVE COOLING IS SUGGESTED

DETAIL A  
SCALE 4 : 1



**APPLICATION NOTES:**  
1- TORQUE APPLIED ON MOUNTING SCREWS: 0.14 Nm (20ozf / in)  $\pm$  10%  
2- FIBERS ARE NOT SHOWN.

Ce document contient des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES. Il demeure la propriété d'ITF Labs et/ou Avensys et ne doit pas être reproduit (en entier ou en partie), transmis, utilisé ou conservé sans permission écrite.

LES DIMENSIONS SONT EN : mm (po)					
TOLÉRANCES (sauf si contre-indiqué)					
UNITÉS	X	X.X	X.XX	X.XXX	Ang.
mm	$\pm 1$	$\pm 0.5$	$\pm 0.25$	$\pm 0.025$	$\pm .5^\circ$
po	$\pm .031$	$\pm .020$	$\pm .010$	$\pm .005$	$\pm .5^\circ$
TOL. FRACTIONS $\pm 1/32"$		FINI DE SURFACE GÉNÉRAL			

CONÇU PAR:	A.WETTER	2006-02-22
DESSINÉ PAR:	A.WETTER	2006-02-22
VÉRIFIÉ PAR:	L. LEDUC	2006-03-23
APPROUVÉ PAR:	DC-1766	2006-MR-27

PROJECTION AMÉRICAIN

**ITF Labs** Avensys  
 (514) 748-4848 www.itflabs.com  
 400 Montpellier, Ville St-Laurent, Qc, H4N 2G7

TITRE  
**APPLICATION NOTE: MOUNTING HIGH POWER PACKAGE**

FORMAT DESSIN NUMÉRO  
**A 10-200141-00-R01**

ÉCHELLE: 2:2 NE PAS MESURER SUR LE DESSIN PAGE: 1 DE 1